

Tervetuloa O-johtavaan

O-Leading pyrkii olemaan yhden luokun ratkaisukumppanisi EMS-toimitusketjussa, mukaan lukien piirilevyjen suunnittelu, piirilevyjen valmistus ja piirilevyjen kokoaminen (PCBA). Tarjoamme joitain edistyneimmistä piirilevyteknikoista, mukaan lukien HDI-piirilevyt, monikerroksiset piirilevyt, jäykät ja joustavat piirilevyt. Voimme tukea prototyypin nopeasta kääntämisestä keskisuurten ja massatuotantoon.

Yleisesti ottaen globaalit asiakkaamme ovat erittäin vaikuttuneita palveluistamme: nopea reagointi, kilpailukykyinen hinta ja sitoutuminen laatuun. Arvokkaamman teknisen palvelun ja kokonaisratkaisun tarjoaminen on O-tapa edetä.

Tulevaisuuden näkökulmasta O-johtava keskittyy aina elektroniikan valmistustekniikan innovaatioihin ja kehitykseen ja pyrkii jatkuvasti PCB: n ja PCBA: n keskitettyyn palveluun tarjoamaan ensiluokkaisia palveluita ja luomaan enemmän arvoa asiakkaillemme.

Kerrokset: 2

Materiaali: FR4

Valmispaksuus: 1.57mm +/- 10%

Ulkopintakerroksen kuparin paksuus: 1oz

Valmis: ENIG (Au: 2-5u ")

Juotosmaski (väri): molemmat sivut, LPI (musta)

Silkkipaino (väri): molemmat puolet, valkoinen

Sähkötesti

LOPPU: TÄMÄN PÖYTÄKIRJAN PITÄÄ JÄLKEEN KYTKETTYVÄKALTA IPC-6012: N MUKAISESTI.

Paksuus tulee olla .050 uM yli 3-6 uM nikkeliä.

Kuparilevyreiät vähintään 0 .025 AVG, .020 min.

Kerroksen avain:

=====

* .GM4: Hallituksen ääriviivat

* .TXT: NC-poratieosto

* .GTP: Top Liitä

* .GTO: Yläilmäsuoja

* .GTS: Top Soldermask

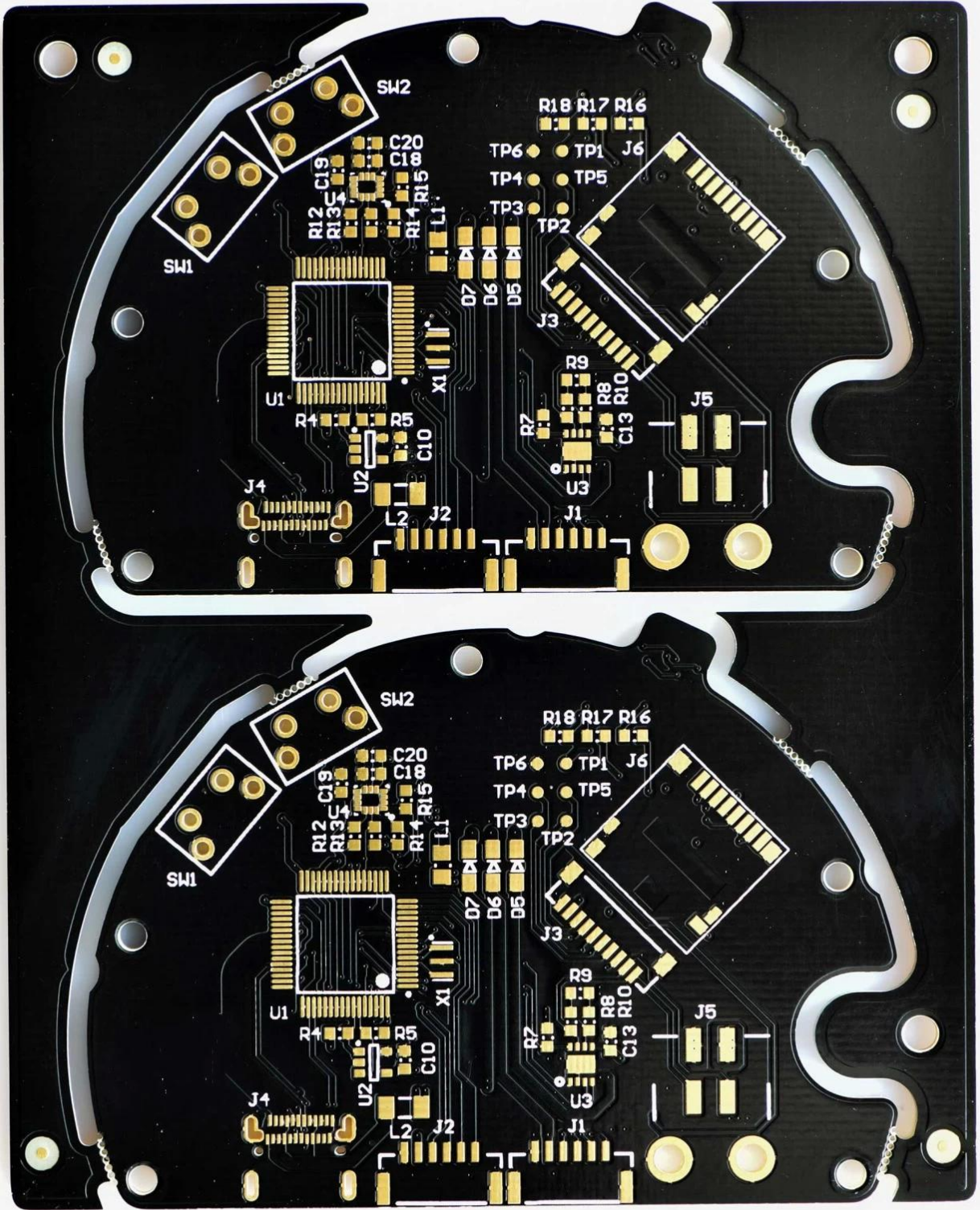
* .GTL: Kuparikerros

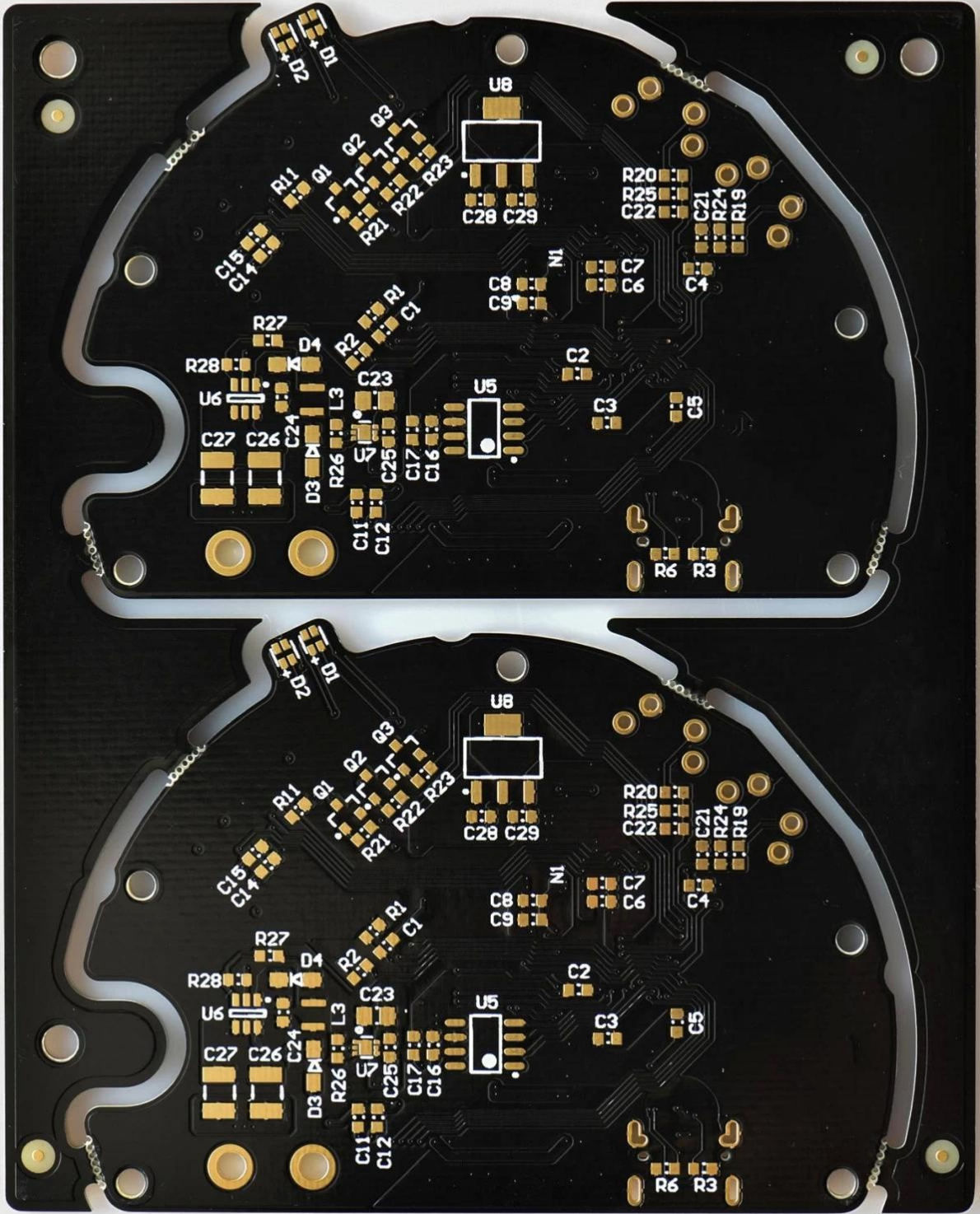
* .GBL: Kuparikerros

* .GBS: Pohjajuotosmaski

* .GBO: Pohjapiirros

* .GBP: Liitä pohjaan





Tiimimme



Factory PCB



Automatic vacuum press machine



Drilling Machine



Pattern Plating Machine



Scrubbing Machine



Developing Machine



Routing Machine

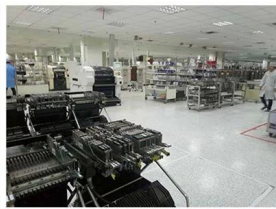


High-speed flying probe machine



E-test Machine

Factory SMT







ZPMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD

E490354

ROOM 1205, 12/F
TAI SANG BANK BLDG
130-132 DES VOEUS ROAD
CENTRAL, HONG KONG

Type	Cond Width		Cond Thk mic(mil)	SS/ DS/ DSO	Max	Max		Meets UL796	C		
	Min	Edge			Area Diam	Solder Limits	Oper Temp			Flame	
	mm(in)	mm(in)			mm(in)	C	sec	C	Class	DSR	I
Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.											
O-LEADING-401	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	-
O-LEADING-407	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	DS	9.7 (0.4)	260	10	130	V-0	All	-
Multilayer printed wiring boards.											
O-LEADING-408	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) Int:136	DS	50.8 (2.0)	280	20	130	V-0	All	*
Single layer printed wiring boards.											
O-LEADING-002	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	All	-
O-LEADING-003	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-
O-LEADING-033	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	All	-
O-LEADING-205	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-206	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-D01	0.14 (0.006)	0.15 (0.006)	33 (1.30)	DS	25.4 (1.0)	260	10	130	V-0	All	*
O-LEADING-S01	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

O-LEADING-S02	0.2 (0.008)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	HB	▲	*
O-LEADING-S03	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.

并不是所有出现在本数据库中的公司名称和产品都满足了UL跟踪检验服务的要求。只有带有UL标志的产品，才应该被视为经过UL认证，并满足UL跟踪检验服务的要求。注意查看产品上的标志。

UL允许在线认证目录中所含材料的复制遵循以下条件：1.指南信息、装配、构造、设计、系统和/或认证（文件）必须在不篡改任何数据（或图纸）的情况下完整且无误导性地呈现。2.经UL允许从在线认证目录转载“声明必须出现在所提取材料的邻近位置。此外，转载材料必须包含以下格式的版权声明：“© 2019 UL LLC”

Shipping service



Quick Turn Lead Time		
Layer Count:	Lead Tim	Special Requirement
1L/2L	2-3days	24 Hours,48 Hours
4L	3-4days	48 Hours
6L	4-5days	72 Hours
8L	5-6days	NA
10L	6-7days	NA
12L	7-8days	NA
14L	8-9days	NA

Standard Lead Time		
Layer Count:	Sample Lead Time	Volume order lead time
2L	4 days	10 days
4L	5 days	11 days
6L	6 days	12 days
8L	8 days	14 days
10L	10 days	16 days
12L	12 days	18 days
14L	14 days	20 days
16-32L	18 days	24 days

Prosessin kyky

Piirilevyjen tuotantokapasiteetit

Kerrosäärä: 1-kerros-32-kerros

Valmiiden kuparien paksuus □ 1 / 3oz-12oz

Min Rivin leveys / etäisyys sisäinen □ 3,0mil / 3,0mil

Min Rivin leveys / välinen etäisyys: 4,0mil / 4,0mil

Suurin kuvasuhde: 10: 1

Levyn paksuus □ 0,2-5,0 mm

Paneelin enimmäiskoko (tuumaa): 635 * 1500 mm

Poratun reiän vähimmäiskoko: 4mil

PI-reikätoleranssi: +/- 3mil

Blind / Buried Vias (All-tyypit): YES

Täyttämällä (johtava, johtamaton): KYLLÄ

Pohjamateriaali: FR-4, FR-4korkean painon halogeeniton materiaali, Rogers, alumiininen pohja,polyimidi,
Raskas kupari

Pintakäsittelyt: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, hopea,Lummersion Tina, kultaiset sormet, hiilimuste

SMT-tuotantokapasiteetit

Piirilevymateriaali: FR-4, CEM-1, CEM-3, alumiinipohjainen levy
Suurin piirilevyn koko: 510x460 mm
Minimi piirilevyn koko \square 50x50mm
Piirilevyn paksuus \square 0,5-4,5 mm
Levyn paksuus \square 0,5-4mm
Komponenttien vähimmäiskoko: 0201
Tavallinen sirukoko-komponentti: 0603 ja suurempi
Komponentin enimmäiskorkeus \square 15mm
Pienin lyijyväli: 0,3 mm
Minimi BGA-palloväli: 0,4 mm
Sijoituksen tarkkuus: +/- 0,03 mm